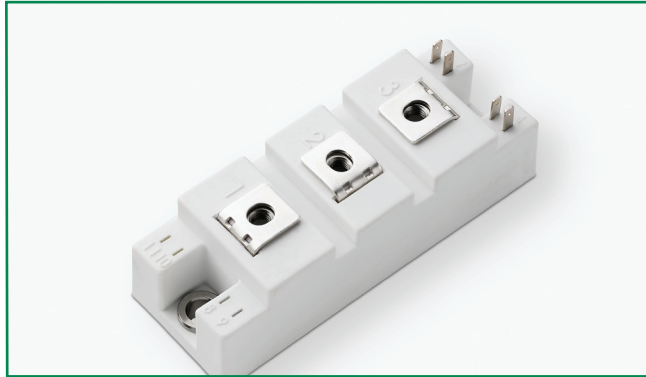


MG1250S-BA1MM



Features

- Ultra Low Loss
- High Ruggedness
- High Short Circuit Capability
- Positive Temperature Coefficient
- With Fast Free-Wheeling Diodes

Applications

- Inverter
- Converter
- Welder
- SMPS and UPS
- Induction Heating

Agency Approvals

AGENCY	AGENCY FILE NUMBER
	E71639

Module Characteristics ($T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
R_{thJC}	Junction-to-Case Thermal Resistance	Per IGBT			0.3	K/W
R_{thJD}		Per Inverse Diode			0.6	K/W
Torque	Module-to-Sink	Recommended (M6)	3		5	N-m
Torque	Module Electrodes	Recommended (M5)	2.5		5	N-m
Weight				150		g

Absolute Maximum Ratings ($T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Values	Unit
IGBT				
V_{CES}	Collector - Emitter Voltage		1200	V
V_{GES}	Gate - Emitter Voltage		± 20	V
I_c	DC Collector Current	$T_c=25^\circ\text{C}$	80	A
		$T_c=80^\circ\text{C}$	50	A
I_{cpuls}	Pulsed Collector Current	$T_c=25^\circ\text{C}, t_p=1\text{ms}$	170	A
		$T_c=80^\circ\text{C}, t_p=1\text{ms}$	110	
P_{tot}	Power Dissipation Per IGBT		500	W
T_J	Junction Temperature Range		-40 to +150	$^\circ\text{C}$
T_{STG}	Storage Temperature Range		-40 to +125	$^\circ\text{C}$
V_{isol}	Insulation Test Voltage	AC, t=1min	3000	V
Diode				
V_{RRM}	Repetitive Reverse Voltage		1200	V
$I_{F(AV)}$	Average Forward Current	$T_c=25^\circ\text{C}$	90	A
		$T_c=80^\circ\text{C}$	60	A
$I_{F(RMS)}$	RMS Forward Current		90	A
I_{FSM}	Non-Repetitive Surge Forward Current	$T_J=45^\circ\text{C}, t=10\text{ms}, \text{Sine}$	430	A
		$T_J=45^\circ\text{C}, t=8.3\text{ms}, \text{Sine}$	450	

Life Support Note:

Not Intended for Use in Life Support or Life Saving Applications

The products shown herein are not designed for use in life sustaining or life saving applications unless otherwise expressly indicated.

MG1250S-BA1MM

Electrical and Thermal Specifications ($T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit	
IGBT							
$V_{GE(th)}$	Gate - Emitter Threshold Voltage	$V_{CE}=V_{GE}, I_C=2\text{mA}$	5.0	6.2	7.0	V	
$V_{CE(sat)}$	Collector - Emitter Saturation Voltage	$I_C=50\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$		1.8		V	
		$I_C=50\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$		2.0		V	
I_{CES}	Collector Leakage Current	$V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$			0.5	mA	
		$V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$		2		mA	
I_{GES}	Gate Leakage Current	$V_{CE}=0\text{V}, V_{GE}=\pm 20\text{V}$	-200		200	nA	
Q_{ge}	Gate Charge	$V_{CC}=600\text{V}, I_C=50\text{A}, V_{GE}=\pm 15\text{V}$		611		nC	
C_{ies}	Input Capacitance	$V_{CE}=25\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$		4.29		nF	
C_{oes}	Output Capacitance			0.30			
C_{res}	Reverse Transfer Capacitance			0.20			
$t_{d(on)}$	Turn - on Delay Time	$V_{CC}=600\text{V}$ $I_C=50\text{A}$ $R_G=18\Omega$ $V_{GE}=\pm 15\text{V}$ Inductive Load	$T_J=25^\circ\text{C}$		270		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		290		ns
t_r	Rise Time		$T_J=25^\circ\text{C}$		60		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		60		ns
$t_{d(off)}$	Turn - off Delay Time		$T_J=25^\circ\text{C}$		480		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		550		ns
t_f	Fall Time		$T_J=25^\circ\text{C}$		60		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		65		ns
E_{on}	Turn - on Energy		$T_J=25^\circ\text{C}$		6.0		mJ
			$T_J=125^\circ\text{C}$		8.4		mJ
E_{off}	Turn - off Energy	$T_J=25^\circ\text{C}$		3.7		mJ	
		$T_J=125^\circ\text{C}$		5.8		mJ	
Diode							
V_F	Forward Voltage	$I_F=50\text{A}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$		1.9	2.3	V	
		$I_F=50\text{A}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$		1.7	2.1	V	
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F=50\text{A}, V_R=800\text{V}$ $di_F/dt=-1000\text{A}/\mu\text{s}$ $T_J=125^\circ\text{C}$		180		nS	
I_{RRM}	Max. Reverse Recovery Current			60		A	
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge			7.1		μC	

Figure 1: Typical Output Characteristics

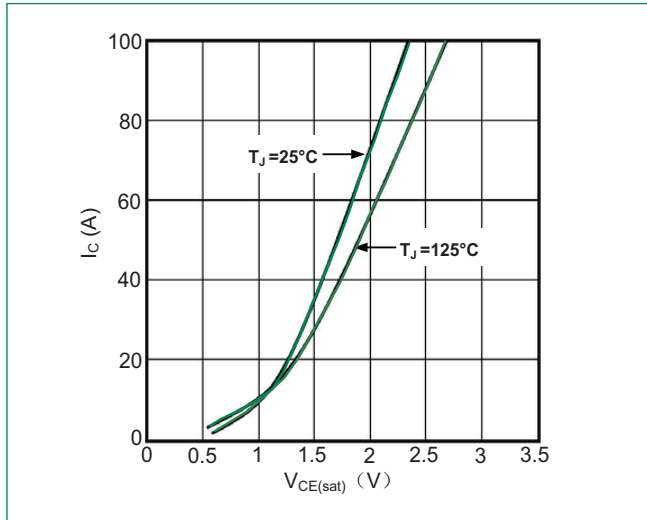


Figure 2: Typical Transfer characteristics

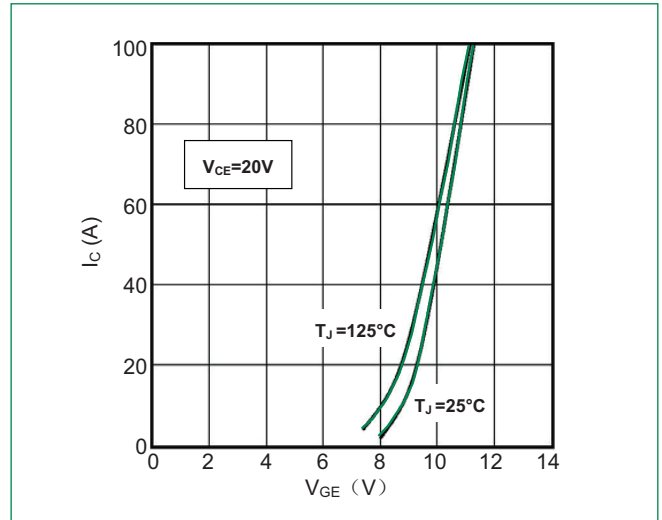


Figure 3: Switching Energy vs. Collector Current

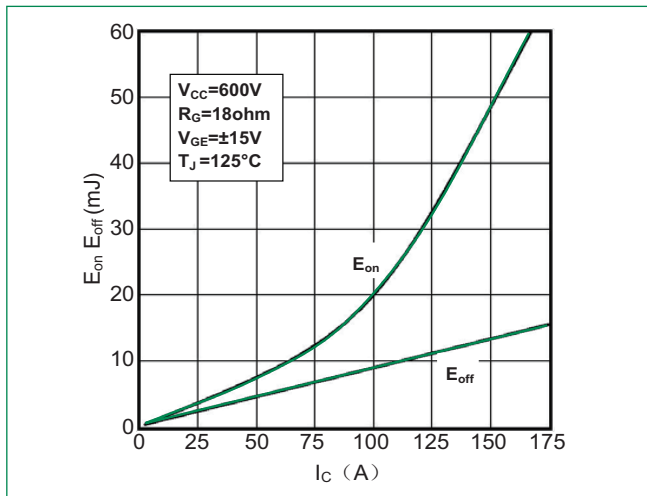


Figure 4: Switching Energy vs. Gate Resistor

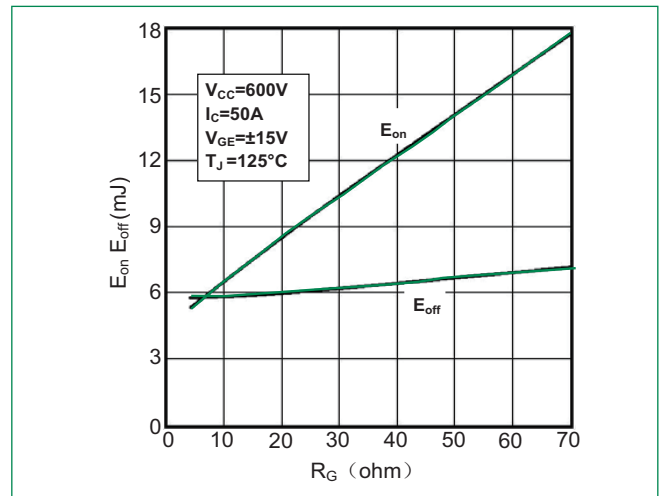


Figure 5: Switching Times vs. Collector Current

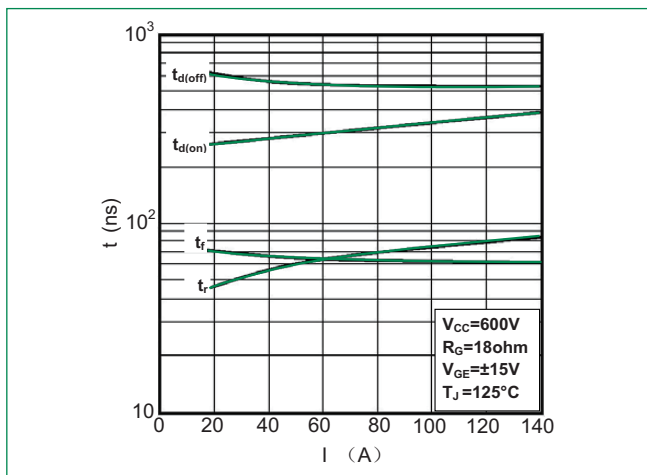


Figure 6: Switching Times vs. Gate Resistor

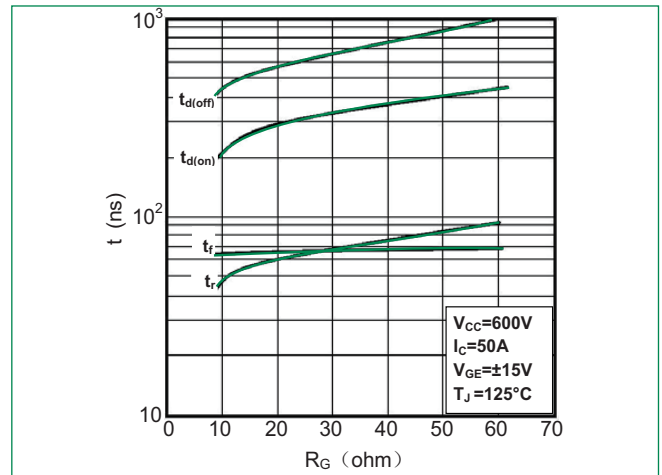


Figure 7: Gate Charge characteristics

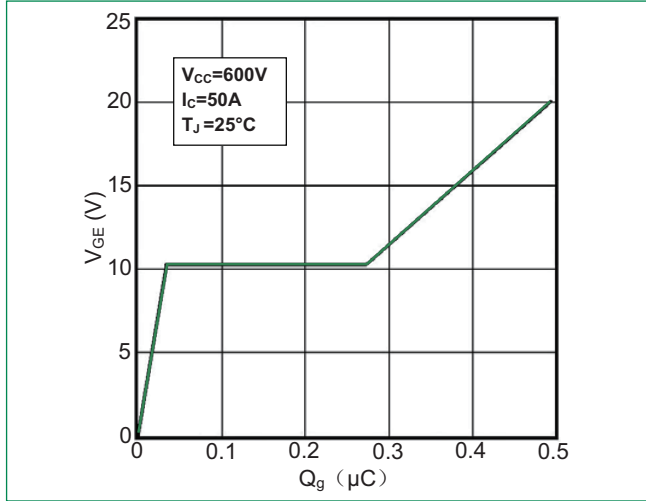


Figure 8: Typical Capacitances vs. V_{CE}

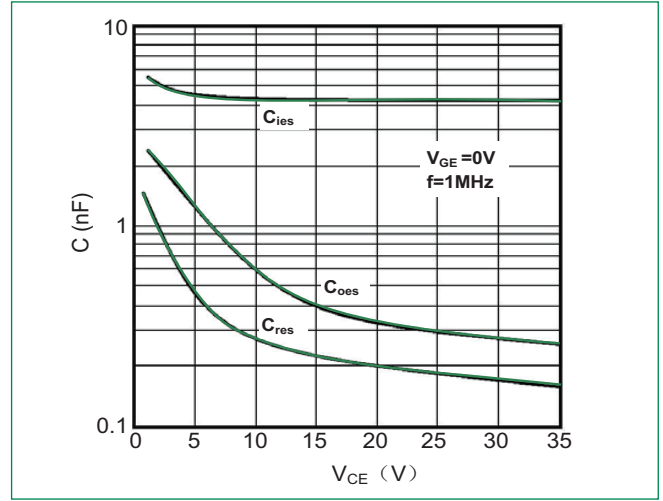


Figure 9: Reverse Biased Safe Operating Area

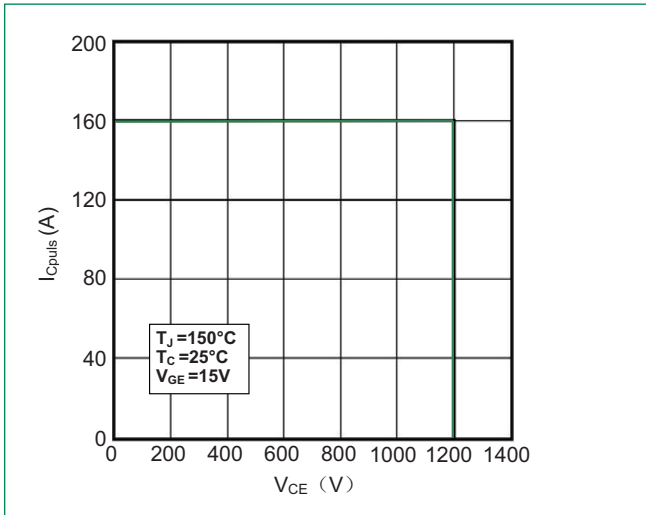


Figure 10: Short Circuit Safe Operating Area

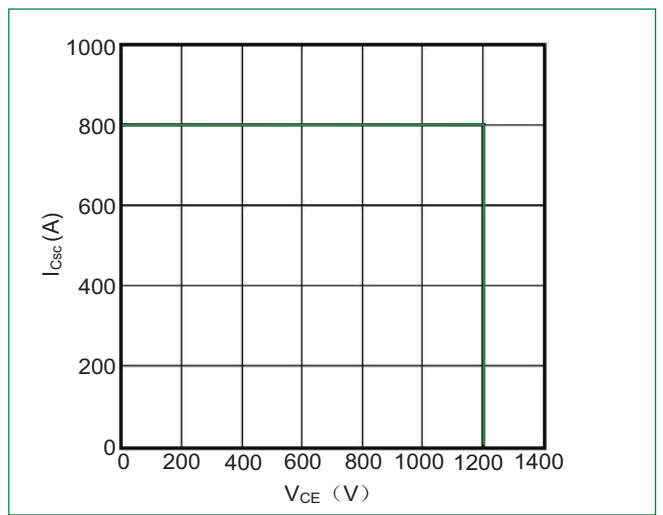


Figure 11: Rated Current vs. T_c

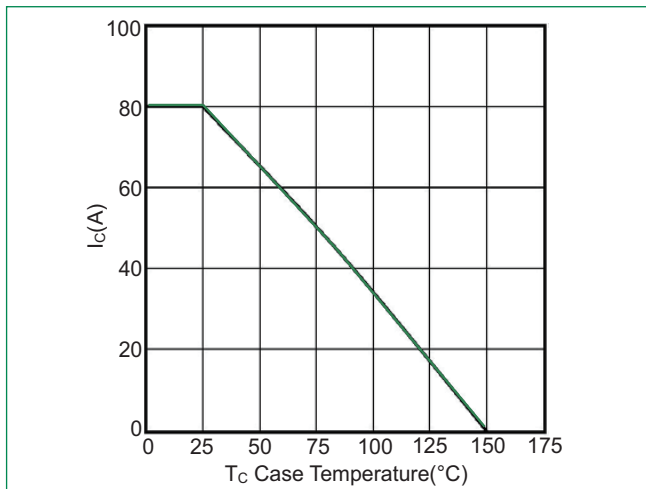


Figure 12: Diode Forward Characteristics

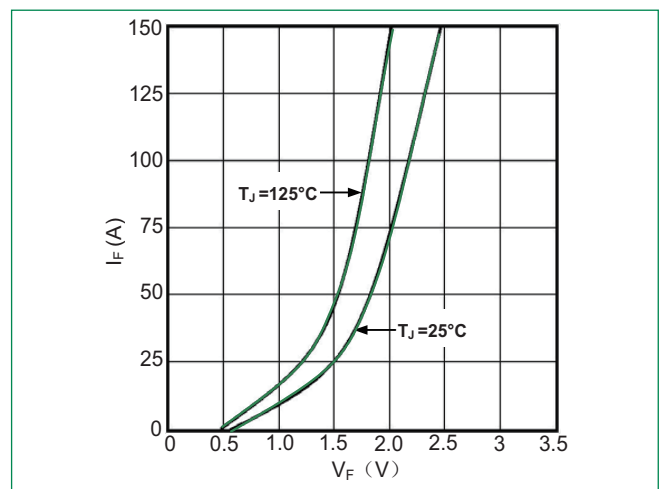


Figure 13: Transient Thermal Impedance of IGBT

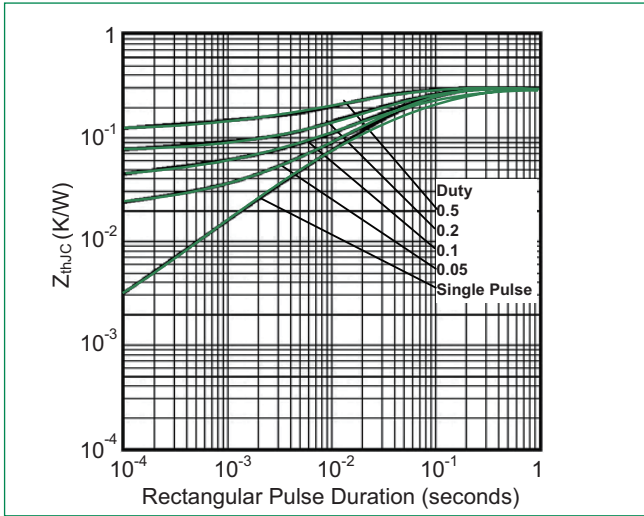
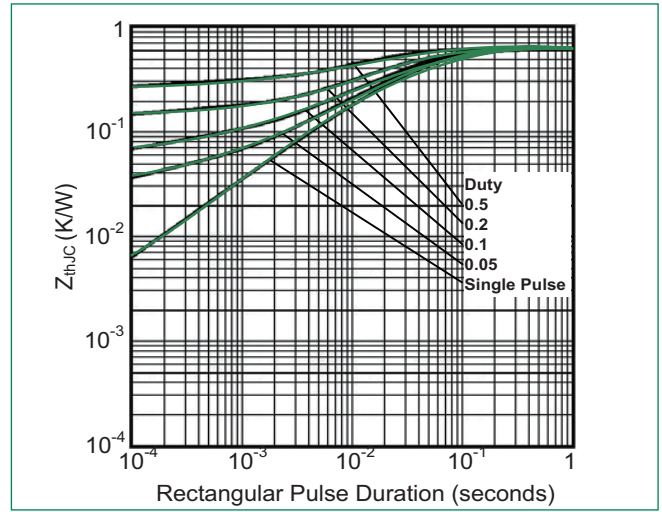
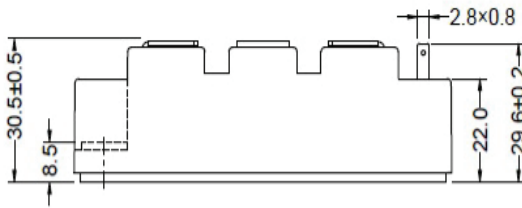


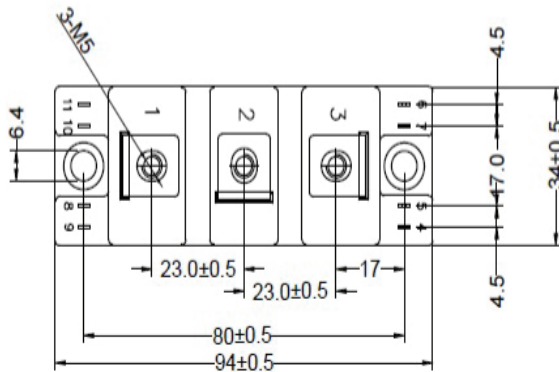
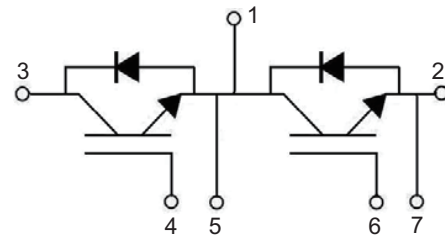
Figure 14: Transient Thermal Impedance of Diode



Dimensions-Package S



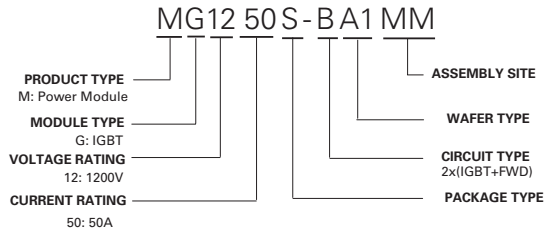
Circuit Diagram



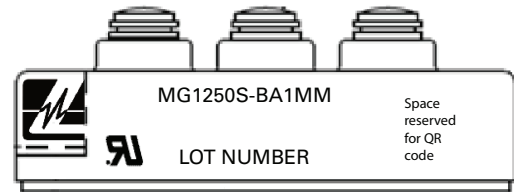
Packing Options

Part Number	Marking	Weight	Packing Mode	M.O.Q
MG1250S-BA1MM	MG1250S-BA1MM	150g	Bulk Pack	100

Part Numbering System



Part Marking System



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9